



ダイボンディング用ペースト

Die Attach Paste

スミレジンエクセル[®] CRMシリーズ SUMIRESIN EXCEL[®] CRM Series

用途と特長

Application and Advantages

CRMシリーズは一液タイプのペーストであり、半導体用のダイボンディング材として汎用パッケージ用から薄型・大型パッケージ用、BGA、CSPなどの先端パッケージの信頼性向上に貢献します。

CRM series are one-component-type die attach pastes for higher reliability of all semiconductor packages.

●半導体パッケージ For Semiconductor Packages

半導体チップとリードフレーム、有機基板との接着、チップ積層等に使用されます。
CRM series are used for adhesive between semiconductor chip and L/F, chip and PWB and multi chip stacking.

●LEDパッケージ For LED Packages

LEDチップと、基板やフレームとの接着に使用されます。
CRM series are used for adhesive between LED chip and substrate / frame.

汎用パッケージ用 For Standard Package

CRM-1084 Series SOT,LED
CRM-1033 Series PDIP,SOIC

BGA・CSP対応 For BGA, CSP Package

CRM-1520 Series 導電タイプ : Conductive-type
CRM-1570 Series 絶縁タイプ : Insulation-type

薄型・大型パッケージ用 For Thin & Large Package

CRM-1076 Series PLCC,QFP,LTQFP,TSOP

高熱電気伝導対応 For High Thermal Conductive & Electrical Conductive

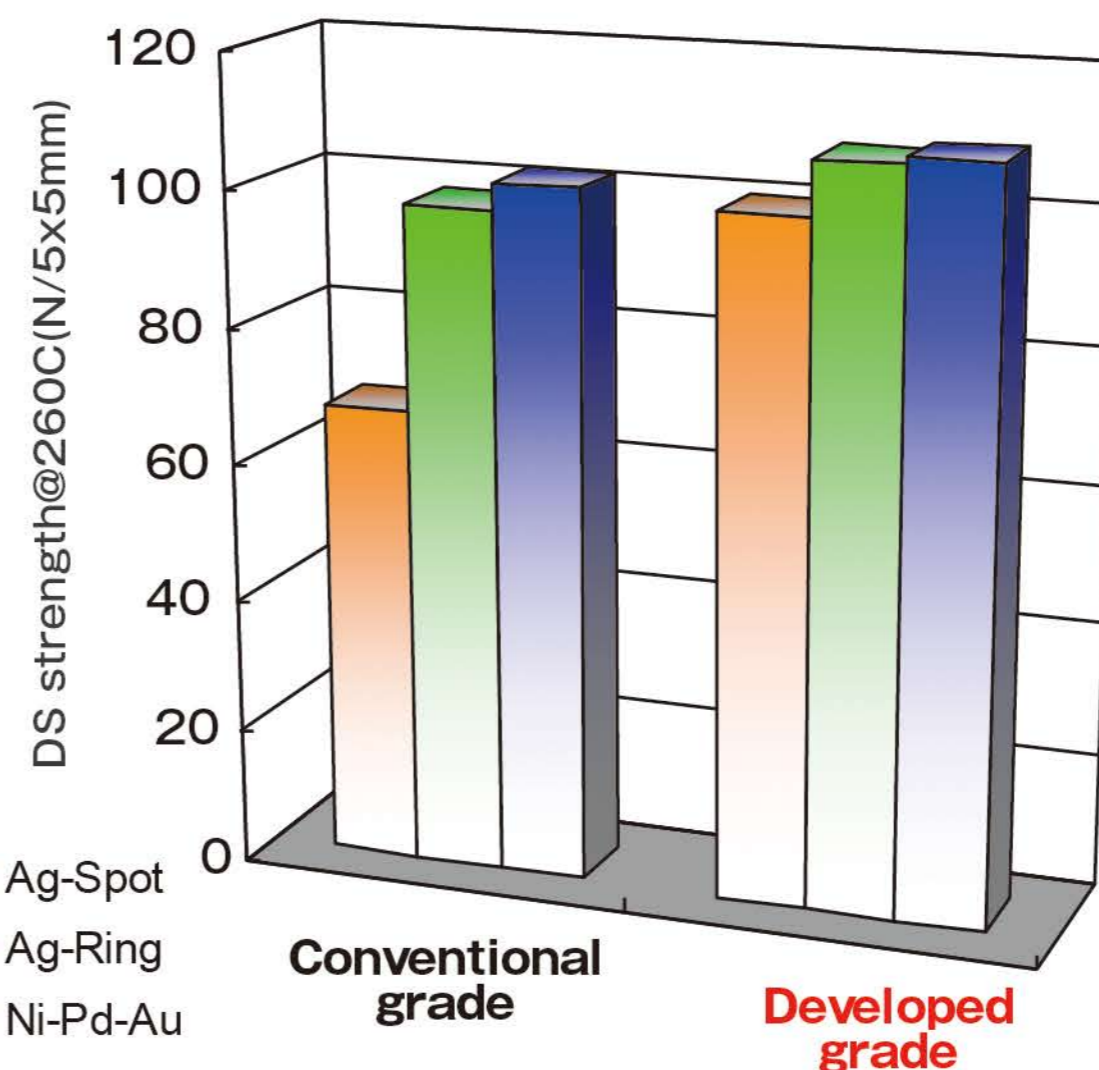
CRM-1290 Series SOT,LED,PDIP,SOIC
CRM-1790 Series PLCC,QFP,LTQFP,TSOP

●信頼性/密着性 Reliability/Adhesion

260℃リフローに対応しております。
銀を含有するペーストに匹敵する密着特性を達成しております。

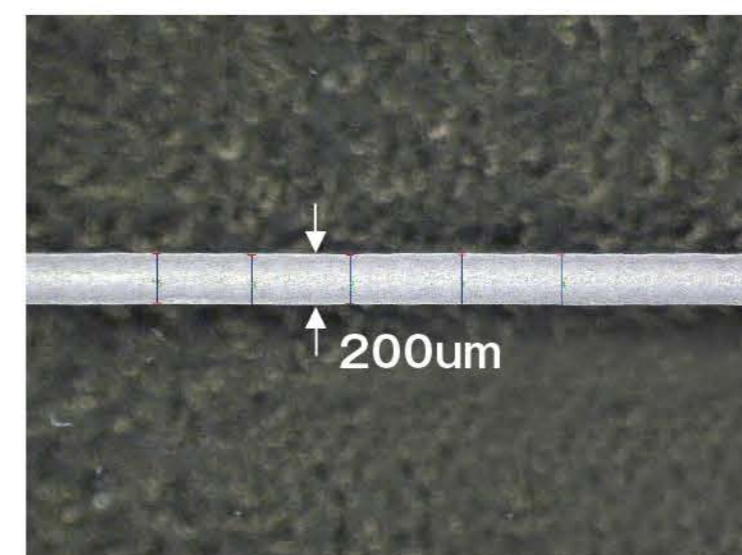
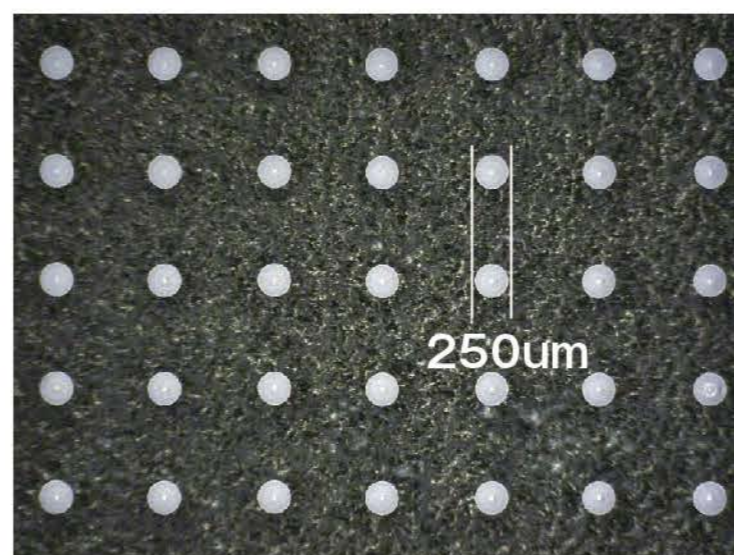
To be suitable for 260°C reflow process.
Developed grade possesses comparable adhesion to Silver paste.

	SAT result after reliability test
Conventional grade	
Developed grade	



●吐出性/描画性 Dispensability/Drawing

小径塗布や描画性に優れています。
Excellent fine diameter dispense and drawing ability.



Cooperation: Musashi Engineering, Inc.